

先导集团子公司

天芯微 2023 届校园招聘简章

【公司简介】

江苏天芯微半导体设备有限公司（隶属于先导集团）坐落于美丽的太湖之滨——江苏省无锡市。我们专注于半导体前道关键工艺机台的研发，主打产品是 IC 制造前道外延设备，广泛应用于 28nm 技术节点的逻辑芯片代工、3D NAND 存储产品、以及诸多功率器件的生产制造。

目前公司的减压外延设备——Epi 300 Compass AP 已成功上市，并已在客户端投入应用。Epi 300 Compass AP 是一款针对先进逻辑代工与存储，以及功率器件中的外延工艺应用需求的减压外延设备，具有先进的红外加热控制技术和加热模块设计，可实现温度的快速升降和温度场的精确控制，使系统具备优异的工艺重复性和设备稳定性，从而获得良好的厚度均匀性、电阻率均匀性，零滑移线和低缺陷密度的外延层生长。可满足工艺均匀性控制、低晶体缺陷、低掺杂和颗粒密度可控性强的要求。

【集团简介】

先导智能成立于 1999 年，为全球最大的锂电池和光伏整线解决方案供应商，中国上市公司 500 强，2022 年福布斯中国创新力企业 50 强，2021 年中国年度最具发展潜力雇主 TOP30。公司建设有 47 万平方米的生产基地和研发中心，拥有员工 15000 余人，其中研发工程师 4500 余人。公司市值超 1200 亿元，上市六年市值增长 68 倍，是锂电池装备板块的 No. 1。主要客户有特斯拉、宁德时代、松下、LG 化学、三星、比亚迪 等国际知名电池企业。

【招聘岗位】

一、机械工程师

岗位职责：

- 1、完成设备图纸设计（三维模型绘制、二维图纸绘制），公差计算，电机，标准件，气动元件选型，图纸细化及工程图出图，BOM 清单整理等
- 2、负责图纸标准化，工装夹具设计，设备说明书编制

任职要求：

- 1、本科及以上学历，硕士优先，机械、自动化、机械制造、流体机械等专业
- 2、熟练使用 solidworks 及 Autocad 软件
- 3、在校成绩优秀、热情开朗、抗压能力强

4、快速学习能力，具备良好的团队合作精神和沟通能力

二、电气工程师

工作职责：

- 1、电气系统图纸设计，绘制电气原理图、电气宏模块布局，报表标签等（基于 Eplan electrical）
- 2、电气程序编写与调试，完成 PLC 的编写（基于 Beckhoff TwinCat3）
- 3、根据所负责的项目进行现场调试，独立处理调试过程中出现的技术问题
- 4、开发基于真空、运动、互锁、加热以及其他电气控制模块，主控软件开发

任职资格：

- 1、本科及以上学历，硕士优先，自动化类、电气类、测控类、电子信息工程类、信息类、机械电子类等相关专业
- 2、具备较强的分析能力和创新意识，善于发现问题并提出可行性解决方案
- 3、快速的学习能力，具备良好的团队合作精神和沟通能力

三、C#软件工程师

岗位职责：

- 1、根据半导体设备需求，开发半导体设备上位机 HMI 软件
- 2、根据设备后端功能要求，开发相应界面及功能
- 3、开发数据分析功能，包括数据库操作、Charting
- 4、部分后端设备功能模块开发
- 5、设备软件的内部/外部调试、测试、维护、升级改进，以及技术支持工作
- 6、撰写设计/开发文档，及时提交软件代码和开发资料
- 7、制作软件开发包等

岗位要求：

- 1、本科及以上学历，硕士优先，计算机、自动化、机电一体化、机械专业
- 2、精通 C#，熟悉 WPF, 设计模式，熟悉 MVVM、状态机模式，精通 XML
- 3、熟悉 WPF Automation 动画功能开发和 WPF Charting 开发，有实时动态曲线的开发经验
- 4、有 SQL 开发经验，熟悉 MySQL, SQLite 数据库者优先
- 5、熟悉 DevExpress 应用开发者优先
- 6、扎实的编程功底和良好的编码习惯，注重用户体验
- 7、良好的沟通、领悟能力，具较强的团队协作精神和敬业精神，能够高效地完成交付的任务
- 8、具有良好的英文读写能力

四、工艺工程师

岗位职责：

- 1、开发新的工艺流程、工艺参数及产品标准
- 2、试片测试表征，整理结果，分析测试数据，提出模型解释实验现象
- 3、协助工程部门对现有硬件设计进行优化改进
- 4、客户宣导以及需求整理；客户 Demo handle
- 5、客户支持，提出设备现场工艺问题解决方案

任职要求：

- 1、博士学历，化学、化工、物理、航空航天、微电子等专业
- 2、有科研项目经验，优秀的分析思考能力
- 3、在校成绩优秀、热情开朗、抗压能力强
- 4、快速学习能力，具备良好的团队合作精神和沟通能力

五、系统工程师

岗位职责：

- 1、半导体装备控制架构设计&优化
- 2、负责推进研发项目顺利开展
- 3、提供设备安全控制策略，把控风险，保证设备在可控条件下安全运行
- 4、整机系统、模块及单元划分，制定设备装调方案
- 5、分析设备运行数据，跟进系统设计优化及问题整改
- 6、整机设计 Spec 管理，协助高层推进关键计划落实

任职要求：

- 1、本科及以上学历，硕士优先，电气自动化、机电一体化、电气专业
- 2、熟悉半导体 Thermal 类化学气相沉积装备设计及工作原理者优先
- 3、熟悉半导体行业 Semi 安全设计标准，有客户端项目经历优先
- 4、在校成绩优秀、热情开朗、抗压能力强
- 5、快速学习能力，具备良好的团队合作精神和沟通能力

六、射频工程师

岗位职责

- 1、半导体设备射频模组的设计开发及优化，如 match、HV；
- 2、腔体及射频通路相关射频参数的提取、分析，解决腔体稳定性问题；
- 3、及时响应客户及其它部门需求，提供故障分析和问题定位；
- 4、和相关供应商紧密沟通合作，保证系统的稳定性；
- 5、准备相关生产文档、BOM。

任职要求

- 1、硕士及以上学历，博士优先，等离子体物理、电磁场与微波、微电子、通信、电子工程相关专业毕业；
- 2、熟悉射频微波电路及电磁场理论，熟悉等离子体基本特性；
- 3、能熟练使用网络分析仪、示波器、频谱仪等测试仪器；
- 4、有射频仿真经验者优先；
- 5、英文读写熟练，能用英语进行专业口语交流；
- 6、工作认真细致，富有团队合作精神、创新精神和良好的沟通能力。

七、制造工程师

岗位职责：

- 1、负责首台样机 SOP 作业指导书的编制，主导对产品技术相关文件（BOM、检验指导书等）的核对、反馈
- 2、负责产品制造工艺流程，装配流程的优化
- 3、讨论研究并解决装配过程中存在的装配工艺技术和质量问题，制定改善方案
- 4、健全装配现场的质量控制手段，逐步提高装配质量
- 5、对来料的质量问题进行处理解决
- 6、协调解决生产线上出现的任何问题以保证生产线的正常运行
- 7、协助装配技工的培养和培训
- 8、完成制造经理安排的其他工作

任职要求：

- 1、本科学历，机械相关专业毕业
- 2、良好的英语读写能力
- 3、熟练使用 solidworks 及 Autocad 软件
- 4、在校成绩优秀、热情开朗、抗压能力强
- 5、快速的学习能力，具备良好的团队合作精神和沟通能力

八、设备工程师

岗位职责：

- 1、负责客户现场设备安装调试及验收
- 2、负责设备日常维护保养、备件更换及问题处理
- 3、负责培训客户设备操作
- 4、协助工艺进行设备性能及产品良率的提高

任职要求：

- 1、本科学历，机电相关专业毕业
- 2、有机械、电气调试经验，或 PLC、伺服、传感器使用经验者优先
- 3、能接受长期出差，具备高度的责任心

4、有光伏、半导体设备安装调试、维保实习经验者优先

九、产品管理工程师

工作职责：

- 1、理解公司战略，制定产品规划，组织进行新产品开发，把控研发项目管理进程
- 2、与产业客户密切互动，精准把握客户需求，熟知竞品信息，反馈给产品研发部门
- 3、负责进行产品定义及企划，组织完成市场调研、客户分析、竞品分析、SPEC定义、产品收益测算等工作
- 4、策划和组织产品立项，输出立项资料，包括调研报告、企划报告、竞品分析报告、市场调研报告等

任职资格：

- 1、硕士及以上学历，材料，电子类或相关专业
- 2、善于沟通、分享、协同，高度的工作责任心和敬业精神
- 3、熟悉行业基本格局，产业趋势，可主动获取市场信息
- 4、良好的英语听说读写能力（CET6 及以上）

【福利待遇】

股权激励、六险一金、免费午晚餐、通讯补助、法定节假日、年休假、节日福利、生日福利、年度体检、现磨咖啡畅饮、结婚生育福利、部门团建基金、入职周年福利、政府补贴（租房、薪酬、购房）等。

【简历投递方式】

投递链接：

<https://docs.qq.com/form/page/DUWtrR1R0UkxSenZr>



扫码上方二维码进行投递

投递需上传成绩单